

Energy efficient

from Cloud to the Edge

10.24 限定 展场好康大放送!
Lucky Draw on the 24th Only!



现场好礼抽奖与冰淇淋派对

最终办法请依官网为主

INVITED BY _____ BOOTH NO. _____

INVITATION

TPCA Show

— TAIPEI —

台湾电子组装/
SMT国际展览会
SMT

台湾电路板产业
国际展览会
PCB

台湾电子封装
国际展览会
IC PACKAGING

立即登录参观
tpcashow.com

台湾绿色科技
国际展览会
GREEN TECH



台湾热管理技术
国际展览会
THERMAL

2025 OCT. 22 WED-24 FRI.

台北南港展览馆一馆 (一楼、四楼) TaiNEX 1, TAIPEI

10:00 - 17:00 (Final Day 15:00)

特别展示 Special Exhibition

终端应用 End Applications

- 电脑 Computing
- 通讯 Communication
- 车载 Automotive
- 航太/军用 Aerospace and Defense
- 消费性电子 Consumer Electronics



AI与智能制造应用 AI and intelligent manufacturing applications

- AI封装检测 AI package inspection
- AI软件开发 AI software development
- Edge AI
- 机器人 robot



热管理与热像应用 Thermal management and thermal imaging applications

- 红外线感测器制程 Infrared sensor process
- 模组封装 Module packaging
- 光学系统及产品应用 Optical systems and product applications



先进制程与高阶封装 Advanced Processes and Advanced Packaging

- CoWoS, CoPos
- FOPLP
- TGV & Glass Core



以上展商仅为随机呈现, 完整名单请上网查询 all exhibitors are on www.tpcashow.com

全球电子产业正在加速跨界融合, 从PCB、SMT、载板到高阶封装与半导体制程, 规模再创历史新高, 逾670+国际品牌、1750个摊位, TPCA Show正是您一站式掌握供应链最新技术、材料与夥伴的最佳平台。我们诚挚邀请您於2025年10月22日至24日亲临台北南港展览馆一馆, 与来自全球的技术专家、创新企业及潜在合作夥伴共襄盛会。

TPCA Show is the leading international exhibition bridging the entire value chain from PCBs, SMT, thermal solutions, substrates to advanced packaging and AI-driven manufacturing. Join us in Taipei and explore what's next.

9大主题分区

IC Substrates, Thermal, Green Tech, Automation, etc.



载板与高阶电路板制造本业区
IC Substrate & PCBs



光电专区
OPTO Pavillion



乾、湿制程设备
Dry & Wet Process Equipment



自动化解决方案
Automation Equipment



高质新材料、耗材与化学品
Materials & Chemicals



绿色科技区
Green Tech



SMT/热管理技术
SMT / Thermal Management



检测设备与软体
Testing Equipment



矽光子专区
HiSPA Pavillion

更多资讯请至官网 For more information Website : www.tpcashow.com

活動介紹 Activity

- 开幕典礼暨主题演讲《产业领航者的AI供应链战略》
Opening Ceremony & Keynote: "AI-Driven Supply Chain Strategies by Industry Leaders"
- 产业领袖高峰会 CEO Summit : 与决策者直接对话
- 半导体与PCB异质整合高峰论坛 :
Semiconductor X PCB Summit
- 洞察未来趋势 Tech X Total solution
 - Pack Vision 封装视界
(CoWoS, CoPoS, Packaging, IC Substrates...)
 - Smart Link 智联制造
(AI、IoT、数智制造、机器人、AI检测与软体...)
 - Next Core 次世代核心
(TGV、Glass Core、FoPLP...)
 - Hyper Edge 高速边缘
(HPC、5G、伺服器、热管理与应用)
 - Auto Next 车用科技 (EV与车用电子)
 - Green Tech 绿能科技 (永续与净零)
- 人才原力媒合=电路板 X Z世代人才
Digital Talent Match Day



鼓励搭乘大众交通工具, 携手减碳共创环境永续, 一起参与绿色看展!
Take rapid transportation, make this world green.



谢绝18岁以下及非相关行业民众入场参观。
Under 18 not admitted.



IMPACT Oct. 21-24
International Microsystems, Packaging,
Assembly and Circuits Technology conference



www.impact.org.tw